

# 工具機公會 助半導體設備在地化

與5大公協會暨4家法人單位合作 簽署跨產業聯盟 估2030年產值翻倍

**【台北訊】**為推動半導體及電子相關設備生產在地化，建立產業生態系（Ecosystem），使台灣企業得以利用跨產業合作發展契機，帶領全球技術革新發展，開創蓬勃商機。工具機公會日前與國際半導體產業協會（SEMI）、電子設備協會等5家公協會，及工研院等4家法人團體單位，共同簽署「推動半導體設備在地化跨產業聯盟」合作備忘錄；活動在行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌等人見證下共同完成簽署儀式。

工具機公會理事長許文憲表示，美中貿易戰與肺炎疫情改變全球供應鏈，半導體是重要戰略產業，龍頭企業要發揮母雞帶小雞的精神。我國半導體設備有高達九成仰賴進口，若要像口罩物資有自產能力，就得跨產業推動半導體設備在地化。首先要了解設備所需標準、取得認證，從周邊設備切入核心領域，由SEMI協助本土供應鏈了解設備標準、取得認證，盼兩年後工具機能大啖商機，產值可望提升20至30%。

SEMI全球行銷長暨台灣

區總裁曹世綸表示，透過SEMI認證教育課程，可讓本土供應鏈更了解半導體相關設備標準，不僅要打入台灣市場，也放眼英特爾、美光等國際大廠。

行政院副院長沈榮津指出，政府已推出外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化、材料供應在地化及技術自主等，以避免半導體技術外流，且日韓貿易戰因材料遭限制就是最好先例，台灣要確保關鍵設備、材料不受制於外商。另教育部也著手修法以培育半導體人才，估計2030年半導體產值可翻



工具機公會理監事代表與SEMI國際半導體協會等5家公協會理事長、執行長暨全球行銷長與工研院、PMC等4家法人團體單位董事長、總經理及貴賓共同合影。

黃奇鐘／攝影

倍、達5兆元的規模。

行政院科技會報副執行秘書葉哲良說，全球半導體設備與工具機設備營收各約600億美元，旗鼓相當，但

獲利仍有差距；而半導體設備與工具機所需零件約有三、四成高度相似度，「強強聯手」可讓台灣產業走得更快。（黃奇鐘）

## 喬陞專注管材加工 邁向工業4.0

**【台中訊】**喬陞機器成立於1983年，以研發與製造各項管材類加工設備為主，在台灣80~90年代出口高速成長期間，扮演了彎管關鍵

方案重要的推手之一。喬陞彎管機行銷全球近40年，源於對管件加工的專精、管材特性的了解、產業需求的提升，於2016年投入光纖雷射管件切割研發，將管

材加工，帶

入新領域。截至2020年第1季，實績出貨涵蓋台灣、義大利、美國、馬來西亞、印尼等地。設備品質除了自把關的ISO 9002，也取得歐盟CE與美國FDA認證，確保耐用度與對人體有效保護。

該公司之多項國際專利，自行設計製造，在品質與服務上更有保障。專利後卡盤設計，高夾持力、重量低、直徑小，轉動慣量業界最低，因此可作高速及高精度切

割。而直徑小的精密設計，更可順利通過前卡盤，讓餘料長度縮短到50~65mm。

專利獨特的前卡盤設計，轉盤重量輕、體積小、精度高、夾持力超強、轉動慣量業界最低，搭配後卡盤作高速、高精密切割。高防塵夾持設計，可有效避免切割粉塵，造成轉盤損壞機會。

雷射自動化方案，實現了製程整合及彈性生產的新生產模式。喬陞提供雷射自



喬陞公司產製的雷射管件切割機名聞全球。

喬陞公司 / 提供



博府智造營運長詹博允（左起）、執行長陳朋馳與夥伴在展場合影。  
黃奇鐘／攝影

## 博府智造 產業擴大收益幫手

**【台中訊】**隨著工業4.0的趨勢興起，許多產業更加重視自動化的重要性，政府近年亦積極推動相關政策，希望透過結合政府、民間產業及學術單位等多方資源，扭轉精密加工產業刻板印象（3K產業一帆驚、勞累、危險），有效提升產業產能及競爭力，促使智慧機械產業蓬勃發展。

博府智造公司表示，以表面處理產業為例，表面拋光研磨技術最為困難，因研磨及拋光等接觸工作控制不易，對於以機器手臂來替代上具有較大的困難度，由於需仰賴控制位置，同時對環境的接觸力量進行控制，因此對較複雜的工件仍以人工方式研磨。為解決此產業痛點，由國立中興大學教授林明澤領軍的價創團隊開發前端動態智慧接觸裝置的技術，利用開發自動補償及柔性力控技術以提升傳統產業的研磨製程，透過智慧的自調適及高度的靈敏性使機器手得以重現老師傅技法，可簡易導入並通用各品牌的機器手臂，快速導入各產業的研磨、拋光等多元自動化表面處理加工應用，且皆可達到在業界對於任何物件的表面加工處理的高精度操作，具備將產線上90%自動化能力的優勢。適用於半導體、工具機、汽車、航太、水五金、衛浴、船舶、廚具及鞋業等零組件產業更快導入智能化生產，提升產能，是產業界擴大收益的最佳幫手。

博府智造公司（04）2284-0832分機204連珮好小姐。  
（黃奇鐘）